

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-256470

(43) 公開日 平成10年(1998) 9月25日

(51) Int. Cl. <sup>4</sup>	識別記号	FI	
H 0 1 L 25/085 25/07 25/18		H 0 1 L 25/08	B

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平9-55176

(22) 出願日 平成9年(1997) 3月10日

(71) 出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72) 発明者 坪野谷 誠

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74) 代理人 弁護士 安富 耕二 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体装置

157. 【要約】

【課題】 複数の半導体チップを積層固着する絶縁性の接着剤に粒径が一定なフィラーを混入することによりチップ間の接触事故を防止する。

【解決手段】 マイランド12上に第1の半導体チップ10を固着し、第1の半導体チップの上に第2の半導体チップ11を固着する。各半導体チップ10、11のボンディングパッド12とリード端子17とをワイヤボンディング。各半導体チップ10、11を含む主要部を樹脂17でモールドする。第2の半導体チップ11を固着する第2の接着剤15に粒径が20～40μmの絶縁性のフィラー20を混入する。